

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加深圳证券交易所“机巧灵动·赋能新制造”主题集体业绩说明会的全体投资者
时间	2025年5月15日
地点	深圳证券交易所； 深交所互动易“云访谈”栏目（ http://irm.cninfo.com.cn ）
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理吕恕女士 副总经理李泽源先生， 财务总监林振荣先生 董事会秘书李小虎先生

投资者关系活动主要内容介绍	1、机器人领域爆发，公司的技术与产品能否满足其技术需求，有什么发展规划？ 机器人一直是固高在部件及系统应用层面落地的重要方向，公司已跟进该领域10多年，协助诸多客户完成特定机器人结合应用场景的系统构建及商业落地。目前公司相关部件和系统产品在机器人领域有一定营收，主要来自工业机器人和物流机器人。对于未来的人形机器人及多轮足机器人，公司十分看好。固高在运控、伺服、编码器等传感类部件以及机器人执行关节部分均有布局，团队正与合作伙伴探索新产品，同时尝试协同客户真实应用场景进行工程化调整，配合主机厂商构建系统，积极挖掘商业场景落地。 2、在半导体设备领域，公司产品的竞争格局如何？ 在半导体设备领域，去年美国将144个厂商加入实体名单，国内在90纳米以下先进制程的运动控制系统和工艺系统主要依赖进口，如刻蚀、CVD工艺主要被发那科、欧姆龙等进口运动控制厂商占据，传片机构主要被布鲁克斯、Yaskawa等国际厂商垄断，国内相关主机企业基于供应风险考虑在尝试导入国内供应。 固高积极响应客户需求，在核心部件方面取得一定突破。在前道晶圆制造先进制程中，产品替代和验证周期较长，目前公司部分产品已通过一些设备工厂验证并出货。在后道封装领域，以键合、固晶、划片为代表，简单芯片（如SOP、单片机芯片）相关产品已批量出货，在AI火爆的背景下，光耦合相关的耦合共晶贴片等产业也有批量出货。在先进复杂制程（如异构封装等复杂芯片焊接）方面，国内设备厂商还在突破阶段，固高正协同这些厂商进行共同研究，产品批量订单可能要等到国产设备厂商在先进制程中通过验证后才会形成。 3、公司针对半导体、机床、机器人等典型高端装备领域有什么不同策略？ 在半导体领域，公司已经在高端装备领域坚持了多年的探索。随着中美政治情形的变化，半导体和机床领域替换机会增多，公司已形成一定产业订单。半导体设备国内复合增长率超过40%，电控系统与部件的价值占比10-15%，市场空间广阔。公司目前在很多基础领域有技术基础且商业闭环已打通，预计未来三年左右能带来较好营收。
----------------------	--

	在高端机床领域，细分品类比半导体设备多很多，各细分领域有不同场景和工艺，工艺迭代和开发需长时间积累，公司积极与第三方团队及自己投资的团队合作，突破各细分领域核心工艺以扩大营收。 在机器人领域，公司将其零部件作为关键业务，在赛道有所投入，积极加入核心零部件（如一体化关节、运控控制系统小脑）研发，为客户提供开发底座，进行实验或小规模量产工作。但公司认为人形机器人的发展仍需时间来实现高价值的应用场景落地，进而形成批量订单，这个周期可能还需要较长时间。公司注重应用场景的落地，关注机器人构型是否适合场景、功能性能能否做到极致以及产品可靠性和稳定性，降低复杂结构带来的故障来源是公司的优势所在。 4、公司最近发布大股东减持公告，这些股东出于什么考量做出减持决定？ 公司2021年以红筹落地方式完成股改。 目前发布减持公告的股东是IPO之前就完成投资的红筹落地到A股的长期机构投资者。这些投资者大部分是在2014年前后投资于公司，其中股东多数已伴随公司成长超过10年。 这些机构投资者此次减持多是基于自身资金周期，实际需求的正常市场行为。
附件清单（如有）	无